

# 金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟

金砖赛组委会函〔2023〕415号

## 关于印发2023一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛之 先进半导体（氮化镓、碳化硅）技术及应用决赛的通知

各相关单位：

2023 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛之先进半导体（氮化镓、碳化硅）技术及应用决赛（学生组、教师组、国际组）兹定于2023年11月24日-11月28日在福建省厦门市举办。依据竞赛技术规程内容及金砖国家技能发展与技术创新大赛的相关精神，现将决赛相关事宜通知如下：

### 一、组织结构

主办单位：

金砖国家工商理事会中方理事会

一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟

中国科协一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新培训中心

联合主办单位：

中国发明协会

教育部中外人文交流中心

承办单位：

金砖国家工商理事会（中方）技能发展工作组

**赛项指导单位：**

中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会

**联合承办单位：**

北京企学研教育科技有限公司

第三代半导体产业技术创新战略联盟

海宁中科半导体科技股份有限公司

厦门科技产业化集团有限公司

厦门市金砖未来技能发展与技术创新研究院

北京嘉克新兴科技有限公司

**协办单位：**

厦门海洋职业技术学院

厦门市集美职业技术学校

**支持单位：**

海宁宁北科技有限公司

普源精电(RIGOL)科技股份有限公司

常州同惠电子股份有限公司

杭州锐进电子有限公司

**二、决赛时间和地点**

时间：2023年11月24日-11月28日

地点：万翔国际商务中心2号楼（厦门市湖里区港中路1690号）

注：裁判人员（含参赛队裁教一体裁判）需11月24日抵达，裁教一体裁判指学生组以校为单位，每校1名指导老师参与执裁，

教师组参赛选手不可兼任学生组裁判。

### **三、决赛报到时间、地点、食宿安排、安全防护、表彰奖励等（详见附件决赛组织方案）**

### **四、决赛竞赛费用**

决赛期间组委会对参赛队不收取任何费用，参赛及比赛期间交通、住宿、餐饮费用自理。

### **五、信息确认**

请参赛机构认真确认参赛选手和指导教师报名信息，如有变更，请务必在 2023 年 11 月 20 日前和大赛组委会确认。

信息确认联系人（电话）：莫鸿鹏（13911394320）。

### **六、赛区组委会及大赛组委会联系方式**

厦门赛区（半导体专项赛）组委会联系方式

联系人：莫鸿鹏（13911394320）

大赛组委会办公室（北京企学研教育科技有限公司）联系方式

联系人：张俊猛（18801349538）王智星（16603414964）

吴林（15810967716）尹华（18201687931）

张思（13681387942）周海燕（13366353668）

联系电话：010-82895227

传真：010-82895227-802 E-Mail: jinzhuan2025@163.com

一带一路暨金砖大赛组委会秘书处(总):崔雪艳（15910438067）

大赛官网：<http://www.brskills.com>

赛项信息发布网站：<http://www.chinajxedu.com>

微信公众号二维码：



附件：先进半导体（氮化镓、碳化硅）技术及应用决赛须知及参赛名单



2023年11月17日